

La loi allemande du 1er novembre 1987 sur la protection des semi- conducteurs

Origine, contenu et problèmes posés*

Thomas Hoeren, Dr. J.
Münster, RFA

1. Origine

Les semi-conducteurs microélectriques constituent le fondement de notre société industrielle moderne. Que ce soit dans les appareils ménagers, les ordinateurs ou les unités de production, les «micropuces»¹ ont de plus en plus d'influence sur notre mode de vie et nos habitudes de travail². Ce développement rapide a aussi

© Thomas Hoeren, 1989.

* Traduction française révisée: original en allemand.

1. Les «micropuces» sont constituées de plaquettes de silicium qui sont «imprimées» avec des circuits intégrés (Integrated Circuits, IC). Ces circuits sont apposés sur les puces de silicium selon un procédé photolithographique et au moyen de pochoirs en verre ou en quartz fabriqués spécialement à cet effet («Masks») et ils envoient des impulsions électroniques permettant à un ordinateur d'effectuer des tâches bien précises. Le modèle de circuit représentable en trois dimensions contenu dans ces pochoirs est appelé «topographie». Pour obtenir de plus amples renseignements sur les principes techniques de la production et de l'utilisation des semi-conducteurs, se reporter à Oxman, «Protection of the Sign of Mikro Circuit Chips», dans: Brooks (éditeur), *Computer Software Protection, A Pragmatic Approach*, presented by the Computer Law Association, Proceedings of the Program, 1982, p. 154 et s.; BAUER, «Urheberrechtsschutz von Schutz und Urheberrecht», partie internationale, 1984, p. 136 et s., p. 145; CAPRON WILLIAMS, *Computers and Data Processing*, 1984, p. 59 et s.; Commission juridique, Rapport des députés Sauter (Ichenhausen) et Stiegler, Journal officiel du Bundestag 11/754, p. 21.
2. Se reporter aussi à Ingwer KOCH, «Rechtsschutz der Topographien von Mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen», dans *Computer und Recht*, 1987, cahier 2, p. 77 à 80.

conféré à l'industrie des semi-conducteurs un véritable âge d'or; depuis, les entreprises allemandes et canadiennes comptent parmi les plus grands fabricants de semi-conducteurs³.

Toutefois, cette nouvelle branche se voit de plus en plus confrontée à une armée de plagiaires dont le but est de reproduire le plus vite possible la structure et le mode de construction d'une puce⁴.

De telles copies sont techniquement faciles à réaliser, en peu de temps, et ne coûtent qu'une infime partie des coûts de développement investis dans une nouvelle puce⁵.

C'est pour cette raison que plusieurs pays industriels ont déjà pris l'initiative d'adopter les lois spéciales de protection pour se garantir contre la piraterie et maintenir la propension à investir et la force d'innovation de l'industrie des semi-conducteurs⁶. C'est tout d'abord aux États-Unis, par le biais du «Semiconductor Chip Protection Act of 1984» du 8 novembre 1984⁷, qu'une protection de type «droit d'auteur» des «mask works» contenus dans la puce à semi-conducteur a été créée contre une reproduction illicite et la diffusion de la puce ainsi fabriquée. Sous certaines conditions, les sociétés étrangères pouvaient temporairement invoquer la protection fournie par le *Semiconductor Chip Protection Act* (17 U.S.C. 914(a)); mais cette protection, dont le Canada et la République fédérale d'Allemagne ont aussi fait usage, était limitée dans le temps et est arrivée à échéance le 8 novembre 1987 (17 U.S.C. 914(e)).

3. Voir notamment pour généralités: Organisation pour la Coopération Économique et le Développement (O.C.D.E.), *The Semiconductor Industry. Trade Related Issues*, Paris, 1985, p. 15 à 30.

4. Se reporter aussi aux informations intéressantes fournies par l'American Electronics Association (A.E.A.) dans *A Bill to Amend Title 17 of the United States Code to Protect Semiconductor Chips and Masks Against Unauthorized Duplication, and for Other Purposes*, Hearing on S. 1201 before the Subcomm. on Patents, Copyrights and Trademarks of the Comm. on the Judiciary, United States Senate, 98th Cong., 1st Sess., Appendix, 151 (1983).

5. Des informations plus précises se trouvent entre autres dans le *Copyright Protection for Imprinted Design Patterns on Semiconductors Chips*, H.R. 1007 before the Subcomm. on Courts, Civil Liberties and the Administration of Justice of the Comm. on the Judiciary, House of Representatives, 96th Cong., 1st Sess., 27 (1979) (testimony of L.J. Sevin, President, Mostek Corp.).

6. Même chose pour la motivation du projet de loi du gouvernement fédéral dans les Bundestagsdrucksachen (journal officiel du Bundestag, BT-DrS) 11/454, p. 12.

7. Voir Public Law 98-620 of Nov. 8, 1984, Chapter 9, Sec. 901-914 of title 17 — Copyrights — United States Code, 17 U.S.C., 98 Stat. 3335 et s.; 3347 à 3356. Senate: 130 Cong. Rec. p. 12909, 12913 (daily ed. Oct. 3, 1984); House of Representatives: 130 Cong. Rec. H 11598, 11602 (daily ed. Oct. 9, 1984). Se référer entre autres aussi à COHODAS, «Computer Chips Protected. Trademark Statute Clarified», (1984) 42 *Cong. Quarterly* 2641; MOORE/SUSMAN, «The Semiconductor Chip Protection Act», (1984) 1 *Computer Lawyer* 11 à 12.

Après cette date, c'est le principe sévère de la «material reciprocity» qui entre en vigueur; selon ce principe, une entreprise étrangère ne peut demander à profiter de cette protection uniquement si son pays d'origine garantit aux ressortissants des États-Unis en substance la même protection que celle offerte par le droit américain (17 U.S.C. § 902(a)(2))⁸. Si, au 8 novembre 1987, le pays d'origine ne remplit pas cette condition, le «mask work» mis au point dans une de ses entreprises risque fort d'être exposé à une exploitation libre et sans limite de la part des entreprises américaines.

Cette situation a entraîné une activité législative fébrile dans les pays occidentaux industrialisés. En premier, ce fut le Japon qui adopta le 31 mai 1985 le «Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit of 1985»⁹, loi qui ne s'appuie pas sur le principe de la «material reciprocity» mais qui prévoit un traitement égalitaire des fabricants de semi-conducteurs japonais et étrangers.

En plus des travaux de l'OMPI à Genève, le Conseil des Communautés Européennes a adopté le 1er décembre 1986 une «directive sur la protection juridique des topographies des semi-conducteurs»¹⁰, afin d'harmoniser le plus possible la législation sur la protection des semi-conducteurs dans les pays membres de la C.E.¹¹. C'est sur la base de cette directive que le gouvernement fédéral allemand a adopté le 14 mai 1987 un «projet de Loi sur la protection des topographies des semi-conducteurs électroniques (Loi de protection des semi-conducteurs)»¹², texte qui, après quelques discussions au sein de la commission juridique¹³ et du Conseil fédéral

8. Il existe certes selon les dispositions de 17 U.S.C. § 902(a) une protection pour les entreprises étrangères, lorsque leur pays d'origine est signataire d'un traité concernant la protection des «mask works» et que les États-Unis ont aussi signé, ou si le «mask work» est d'abord exploité commercialement aux États-Unis. Comme il n'existe pas encore de tel traité et que les entreprises étrangères commencent en général par commercialiser leur puce sur leur territoire national, cette disposition n'est d'aucune utilité.

9. Loi no 43 du 31 mai 1985: Industrial Property 9/1985, Japon — texte 10001, p. 1 à 11: revue sur les brevets, les échantillons et croquis, 1986, p. 356 et s.

10. Directive du 16 décembre 1986 — 87/54/CEE, journal officiel no L 24/36 du 27 janvier 1987, *Computer und Recht*, 1987, cahier 2, p. 149 et s. (traduction en allemand). Se référer aussi à la proposition de la Commission du 23 décembre 1985 à ce sujet — Doc-CE KOM (85) 775: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, partie internationale 1986, p. 465 à 467 (traduction en allemand).

11. Pour l'état actuel de la législation dans les pays de la CE, se référer aux rapports des délégations nationales pour le XXIIIème congrès de l'AIPPI à Londres du 8 au 13 juin 1986, Q 57, dans: Annuaire de l'AIPPI 1986/1.

12. Projet de loi du 14 mai 1987, Bundestagsdrucksache (BT-DrS 11/454), *Computer und Recht* 1987, cahier 6, p. 398 et s.

13. Se référer à la décision recommandée et au rapport de la commission juridique — Bundestagsdrucksache 11/754.

(Bundesrat), a acquis force de loi le 1er novembre 1987 sans changements fondamentaux.

2. Contenu

Cette loi se caractérise par l'établissement d'un nouveau droit de protection industrielle sui generis qui renferme aussi bien des éléments de la protection du type «droit d'auteur» que de la protection de la propriété industrielle.

2.1 Objet et efficacité de la protection

La loi prévoit une protection des seules «topographies». Elle utilise ici une autre terminologie que le modèle américain («mask work») ou la loi japonaise («circuit layout»). Toutefois, les trois textes se réfèrent au même objet de protection¹⁴.

Dans le § 1 I 1, les topographies sont définies comme «structures tridimensionnelles des semi-conducteurs microélectroniques». Comparée aux usages linguistiques extrêmement compliqués et rigides de la directive européenne, cette définition se caractérise par sa clarté et son ouverture à de nouveaux développements dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs¹⁵.

Une topographie n'est protégée que lorsqu'elle possède des traits distinctifs (§ 1 I 1). En vertu de la définition de ce concept au § 1 II, une topographie ne présente de traits distinctifs «que lorsqu'elle est le résultat d'un travail de réflexion, qu'elle n'est pas la simple reproduction d'une autre topographie et qu'elle n'est pas ordinaire». La notion de traits distinctifs est totalement étrangère au droit allemand de la propriété intellectuelle; selon la volonté du législateur, elle doit mettre en valeur le caractère sui generis de la nouvelle protection légale¹⁶. Que ce nouveau règlement soit dans son ensemble une réussite, nous osons en douter: si le design d'une puce originale est copié avec de légères modifications, il n'y a pas lieu d'y voir une «simple» reproduction; en cas de doute, la seconde puce pourrait bénéficier de la protection. En outre, à notre avis, le critère d'«ordinaire» n'est pas facile à concrétiser. Certes, le législateur part du fait qu'il existe une norme bien définie dans le domaine de l'industrie des semi-conducteurs, mais cette affirmation me paraît très douteuse du fait même des développements très rapides que connaît ce secteur industriel. Même si l'on admet qu'une telle norme

14. Voir aussi KOCH (note 2), *Computer und Recht* 1987, cahier 2, p. 79.

15. Voir pour la motivation du projet de loi — Bundestagsdrucksache (BT DrS) 11/454, p. 15.

16. Motivation du projet de loi: Bundestagsdrucksache 11/454, p. 15.

existe bel et bien, il semble cependant très difficile dans des situations particulières — par exemple, en cas de litige entre fabricants internationaux de semi-conducteurs — de concrétiser ce concept de façon liante. Par conséquent, nous sommes justifié d'attendre avec impatience les premières décisions rendues par les tribunaux en rapport avec cette loi.

2.2 Bénéficiaires de la protection légale

En vertu du § 2 I, la protection appartient à celui qui a créé la topographie; dans le cadre de rapports employeur-employé, elle revient cependant à l'employeur (§ 2 II). Toutes les personnes titulaires de la nationalité d'un État de la CE ou ayant leur résidence habituelle ou étant établies sur le territoire d'un État membre de la CE ont droit au même traitement en vertu du principe du «national treatment» (§ 2 III).

Les fabricants de semi-conducteurs originaires de pays n'appartenant pas à la CE sont toutefois exclus de ce principe du «national treatment»; ils sont soumis à la «material reciprocity», à l'instar du modèle américain. Leurs produits ne pourront bénéficier de la protection légale accordée par cette loi que si un traité international ou le droit communautaire stipulent que ces fabricants ont droit au même traitement que les nationaux, ou si une déclaration du ministre fédéral de la justice atteste que le pays d'origine des semi-conducteurs accorde aux entreprises allemandes une protection semblable (§ 2 VI)¹⁷.

Le législateur allemand utilise un double langage dangereux et regrettable: d'un côté, il déplore l'introduction du principe de réciprocité dans le *Semiconductor Chip Protection Act* des Américains¹⁸ et, de l'autre côté, il intègre ce même principe dans la loi allemande. Il fait ainsi preuve d'une mentalité que l'Ancien Testament exprime dans les mots suivants: «Oeil pour oeil, dent pour dent»¹⁹. L'exemple susmentionné du Japon montre qu'il aurait été tout à fait possible

17. En vertu de l'article 3 II 7 de la directive de la CE mentionnée ci-dessus, la République fédérale d'Allemagne ne peut plus conclure de tels accords en toute liberté, étant donné que la Commission des CE doit auparavant être entendue. Se référer à ce sujet à la Bundestagsdrucksache 11/454, p. 18.

18. KOCH, qui a lui-même beaucoup participé à l'élaboration de la loi allemande, écrit dans *Computer und Recht* 1987, cahier 2, p. 78: «Ce règlement va à l'encontre d'une tradition vieille de plusieurs siècles en matière de droit d'auteur et de protection de la propriété industrielle. Le rédacteur aimerait exprimer le désir que ce règlement ne constituera qu'un faux pas unique dans le domaine du droit d'auteur et de la protection de la propriété industrielle».

19. Il est à notre avis tout aussi regrettable que les motifs du projet de loi donnent l'impression que l'on n'ait pas utilisé le principe de la «material reciprocity»; se référer au Bundestagsdrucksache (BT-DrS) 11/454, p. 18.

et sensé d'accorder aux sociétés étrangères le principe du traitement national sans la réciprocité.

Cette attitude étrange de la loi allemande envers les fabricants étrangers de semi-conducteurs est encore renforcée par des vides juridiques évidents et inacceptables à l'heure actuelle. Dans le *Semiconductor Act*, le design d'une puce est protégé s'il est tout d'abord commercialisé sur le marché américain, indépendamment du pays d'origine du fabricant (17 U.S.C. § 902(a) 1. (B)). Cette disposition vraiment généreuse ne trouve pas d'équivalent dans la loi allemande de protection des semi-conducteurs, et on peut s'en étonner. Ainsi, une entreprise étrangère ne peut s'en remettre qu'à son pays d'origine pour pouvoir commercialiser ses puces en République fédérale d'Allemagne et ce, après conclusion des accords correspondants ou adoption des lois de protection nationale nécessaires.

Mais cela n'est pas tout: par rapport au droit américain déjà si protectionniste, le législateur allemand refuse aussi aux entreprises étrangères une protection intérimaire réelle. Si le texte 17 U.S.C. § 914(a) accordait une protection intérimaire aux «mask designs» étrangers, une telle disposition semble avoir été oubliée en République fédérale d'Allemagne où le législateur semble n'avoir pu se résoudre à accorder une aide aussi généreuse aux concurrents ne faisant pas partie de la CE²⁰. De ce fait, même si le Canada s'efforce vraiment d'établir des mesures de protection efficaces des puces, cela ne suffit pas pour que les entreprises canadiennes de microélectronique se voient bénéficier de la protection de leurs topographies en R.F.A. Présentement, elles ne peuvent se défendre contre une reproduction illimitée et une commercialisation de leurs produits.

Dans leur ensemble, ces règles concernant les fabricants de semi-conducteurs non originaires des pays membres de la CE

20. L'absence de réglementation dans ce domaine est tout simplement insupportable; des pays comme le Canada entreprennent des efforts importants afin de mettre au point un texte législatif pour la protection des puces; se référer à ce sujet à *Report of The House of Commons Standing Committee on Communications and Culture's Sub-Committee on the Revision on Copyright, A Charter of Rights for Creators* (1985, Ministry of Supply and Services Canada), p. 46 à 48; Government of Canada, *Government Response to the Report of the Sub-Committee on the Revision of Copyright* (February 1986), p. 9. Les efforts entrepris par le Canada ont été reconnus suffisants par les États-Unis afin de garantir aux puces canadiennes la protection intérimaire prévue par le texte 17 U.S.C. § 914(a). Je ne saurais dire pourquoi les efforts des Canadiens ne sont pas honorés comme ils le devraient en République fédérale d'Allemagne, d'autant plus que la directive de la CE ne se prononce pas sur le sujet des «règlements transitoires» et laisse donc la voie ouverte aux gouvernements nationaux.

s'avèrent très insuffisantes et susceptibles de modifications. Le règlement tel qu'adopté donne l'impression d'avoir voulu créer un texte assurant aux entreprises allemandes une protection efficace sur leur territoire et à l'étranger tout en voulant se protéger contre la concurrence étrangère.

2.3 Formalités d'enregistrement

Les topographies répondent aux mêmes formalités d'enregistrement que les droits de propriété industrielle traditionnels; en République fédérale d'Allemagne, le propriétaire d'une topographie devra donc la faire enregistrer auprès de l'Office allemand des brevets (§ 3)²¹. En effet, seules les personnes ayant fait enregistrer leur topographie auprès de cet organisme pourront se prévaloir de la protection légale (§ 5 III); quiconque n'aura pas répondu à cette obligation dans les deux ans suivant la première exploitation officielle des topographies perdra toute possibilité d'obtenir une protection (§ 5, no 1, al. 2).

L'enregistrement comprend, entre autres, le formulaire d'enregistrement correspondant, la présentation des documents concernant l'identification et l'utilisation de la topographie en question ainsi que le paiement d'une taxe administrative unique de 500 - DM (environ 365\$ can.) (§ 3 II et § 3 V).

L'Office des brevets vérifie si les documents d'enregistrement sont complets et remplis correctement; il ne contrôle ni la qualité de la personne souhaitant enregistrer, ni l'exactitude des faits notés dans la demande, ni les traits caractéristiques de la topographie (§ 4 I). Toutefois, chacun peut invoquer auprès de l'Office la non-qualification de la personne ayant procédé à l'enregistrement ou l'absence d'un critère donnant droit à une protection de la topographie. Toute contestation fondée peut entraîner la radiation de l'enregistrement au registre (§ 7 I et § 8 I).

2.4 Durée de protection

La protection d'une topographie débute avec sa première exploitation industrielle ou avec la demande d'enregistrement auprès de l'Office allemand des brevets; c'est la date antérieure qui fait autorité (§ 5 I). La protection arrive à échéance à la fin de la dixième année de calendrier, l'année de début de la protection servant de point de départ (§ 5 II). Si la protection n'a pas été mise à profit

21. Office allemand des brevets, Zweibrückenstr. 12, D-8000 Munich 2. L'Office dispose de renseignements plus précis concernant l'enregistrement des micropuces.

dans les quinze ans suivant le premier enregistrement de la topographie, elle disparaît (§ 5 IV).

2.5 Effets

À l'instar de la législation allemande sur le droit d'auteur, cette nouvelle protection légale comporte tout simplement l'interdiction de reproduire ou d'exploiter la topographie en question (§ 6 I). Toute infraction est sanctionnée, du point de vue civil, par une poursuite en dommages et intérêts et en manquement aux obligations énoncées par la loi (§ 9) et, du point de vue pénal, par une peine d'emprisonnement pouvant atteindre un an ou une amende (§ 10).

Selon la loi, la simple possession ou l'emploi d'une topographie par des tiers sont autorisés; seul l'avenir démontrera si cette restriction est vraiment fondée et tournée vers la pratique.

En outre, les effets de ce régime de protection sont limités par plusieurs exceptions (§ 6 III, nos 1 à 3). Ainsi, l'article 6 II no 1 permet l'utilisation, à des fins non commerciales, c'est-à-dire sans but lucratif, par le secteur privé d'une topographie privée²². En vertu de l'article 6 II no 2, toutes les utilisations non commerciales d'une topographie, c'est-à-dire analyse, enseignement et recherche, sont tolérées.

De plus, l'exigence américaine de «material reciprocity» a contraint le législateur allemand à incorporer dans la nouvelle loi deux exceptions tirées du *Semiconductor Chip Protection Act*, exceptions connues dans le droit américain mais étrangères au droit allemand.

Selon l'article 6 II no 3, un tiers peut analyser une topographie protégée et utiliser le résultat de son analyse pour fabriquer et exploiter sa propre topographie; ce principe du «reverse engineering», autorisé par le texte 17 U.S.C. § 906(a)(2), ne peut être exercé qu'à la condition que la nouvelle topographie présente des traits distinctifs au sens de l'article I II (voir page 4) et ne soit donc pas une simple reproduction de la topographie d'origine. Mais la loi américaine fait déjà preuve d'un manque de clarté à ce sujet et est l'objet d'une controverse: selon quels critères l'originalité du nouveau «mask work» fabriqué selon le principe du «reverse engineering» doit-elle être jugée²³?

22. Telle était la motivation du projet de loi. Bundestagsdrucksache 11/454, p. 22.

23. Se référer à David LADD, David E. LEIBOWITZ, Bruce G. JOSEPH, *Protection for Semiconductor Chip Masks in the United States*, Weimheim, 1986.

Le renvoi peu clair et peu utile à la «simple» reproduction va certainement entraîner en République fédérale d'Allemagne une nouvelle discussion encore plus véhémente à ce sujet²⁴.

Le second principe de la loi américaine inséré dans le texte allemand²⁵ porte sur le «innocent infringement»: en vertu de l'article 6 III, l'acquisition de bonne foi d'un semi-conducteur comprenant une topographie protégée ne tombe pas sous le coup de l'interdiction d'exploitation. Cependant, dès que l'acquéreur de bonne foi est au courant ou devrait être au courant que la topographie peut être protégée, il est tenu de verser au propriétaire de ladite topographie un dédommagement pour toutes les exploitations commerciales à venir.

2.6 Dispositions transitoires

Selon l'article 26, seules les topographies exploitées commercialement pour la première fois depuis le 1er novembre 1985 pourront bénéficier rétroactivement de la protection accordée par la loi. Cependant, par principe, seules les infractions à cette loi commises *après* son entrée en vigueur pourront être prises en considération²⁶.

Ici, le législateur allemand semble être plus restrictif et prudent que son homologue américain: en effet, le *Semiconductor Chip Protection Act* prévoit une protection *totale* de toutes les puces introduites sur le marché depuis le 1er juillet 1983 (17 U.S.C. § 913(d), no 1).

3. Problèmes posés

Grosso modo, le législateur allemand a, avec la *Loi sur la protection des semi-conducteurs*, élaboré en peu de temps un règlement pragmatique et ouvert aux développements futurs du marché des puces. Mais cette course contre la montre a laissé certaines questions sans réponse:

a) Comment déterminer les «traits distinctifs» d'une puce par rapport aux simples reproductions? Ce problème devrait donner lieu à quelques discussions entre juristes et agents de brevets dans les mois à venir.

b) Dans l'ensemble, cette loi ne peut se targuer d'être particulièrement favorable aux étrangers. Son caractère

24. Se référer à KOCH (note 18), *Computer und Recht* 1987, cahier 2, p. 79.

25. Soit 17 U.S.C. § 907 et art. 24 de la loi japonaise.

26. Se référer à la motivation du projet de loi — Bundestagsdrucksache 11/454, p. 27.

protectionniste a peu de chance d'inciter d'autres pays à renoncer au principe fatal de la «material reciprocity» dans leurs réglementations.

c) La législation en vigueur renvoie expressément à la faculté du fabricant de semi-conducteurs de se prévaloir des lois relatives aux droits d'auteur et aux brevets, en plus des droits accordés par la nouvelle loi²⁷. Malgré les risques de procès qui sont liés à cela, nous ne saurions trop recommander aux fabricants canadiens de mettre toutes les chances de leur côté en invoquant la protection fournie par la législation sur les droits d'auteur et celle sur les brevets ainsi que la protection fournie par la nouvelle loi²⁸.

d) Il est difficile d'évaluer la portée que la *Loi sur la protection des semi-conducteurs* aura en pratique.

Le *Semiconductor Chip Protection Act* américain, réclamé à cor et à cri, n'a pour le moment été l'objet d'aucun litige²⁹. Il faut maintenant attendre l'attitude des tribunaux allemands vis-à-vis la *Loi sur la protection des semi-conducteurs*. Étant donné que certains principes — comme par exemple le «reverse engineering» — sont tout à fait étrangers au droit allemand, nous sommes en droit de supposer que les premières discussions juridiques ne vont pas tarder.

27. Selon le Bundestagsdrucksache 11/454, p. 13: «Pour les circuits intégrés, ... une protection par brevet est par principe possible pour des inventions dans le domaine des procédés de fabrication, des fonctions du circuit et aussi des structures des semi-conducteurs. (...) Si elles répondent à des critères particuliers et stricts, les topographies des semi-conducteurs ainsi que les croquis destinés à la fabrication de ces topographies peuvent bénéficier d'une protection de type droit d'auteur en vertu de l'article 2, al. 1, no 7 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Certes, au même endroit, le législateur émet des réserves quant à la possibilité d'une protection par le droit d'auteur ou le brevet pour les cas particuliers en raison des exigences très hautes de ce type de protection. Seules les discussions juridiques et les décisions prises par les tribunaux pourront dans l'avenir apporter une réponse à cette question.

28. En ce qui concerne la discussion sur une protection par le droit d'auteur ou le brevet pour les microprocesseurs aux États-Unis, voir Oxman, «Intellectual Property Protection and Integrated Circuit Masks», (1980) 20 *Jur. J.* 405; REDMOND, «Industrial Design in High Technology — Legal Protection Considerations», (1980) *Pat. L. Ann.* 79; COHEN SWARTZ, «Chip Protection at Least — Dial *M* for Mask Works», (1984) 7 *Copyright management* 2.

29. Se référer à LAURIE, «The First Year Experience Under the Chip Protection Act», (1986) 20 *The Computer Lawyer*, Vol. 3, No 2, p. 11.